



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE
JAPANESE
ENGLISH

【 1. 適用範囲 SCOPE 】

本仕様書は、_____ 殿 に納入する
microSD CARD CONN. について規定する。

This specification covers the microSD CARD CONN. series for limited use by _____.

【 2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 】

製品名称 Product Name		製品型番 Part Number
カードコネクタ CARD CONNECTOR	無鉛 LEAD FREE	502570-0831
エンボス梱包品 Embossed Package	無鉛 LEAD FREE	502570-0893

* : 図面参照 Refer to the drawings.

【 3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES 】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (Maximum.)	10 V	[AC (実効値 rms) / DC]
最大許容電流 Rated Current (Maximum.)	0.5 A	
使用温度範囲 Ambient Temperature Range. (Operating)	-25°C ~ +85°C *1	
保存温度範囲 Storage Temperature Range. (Non-Operating)	-40°C ~ +85°C	
使用湿度範囲 Ambient Humidity Range.	95% R. H. maximum *2	

*1 : 通電による温度上昇分も含む。Including terminal temperature rise.

*2 : 結露無きこと。Non-condensing.

REV.	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
SHEET	1~15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
REVISE ON PC ONLY										TITLE: microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書										
B	変更 REVISED J2012-0813 '11/12/14 A.IDA									THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										
REV.	DESCRIPTION																			
DESIGN CONTROL J					STATUS					WRITTEN BY: Y.MATSUMOTO	CHECKED BY: M.TOMITA	APPROVED BY: YO.ITO	DATE: YR/MO/DAY 2007/05/08							
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001															FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 1 OF 15				



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【 4. 性能 PERFORMANCE 】

4-1. 電氣的性能 Electrical Performance

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1 接触抵抗 Contact Resistance	ダミーカード ^{*3} を嵌合させ、開放電圧20mV以下、 短絡電流10mAにて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate dummy card ^{*3} , measure by dry circuit, 20mV maximum, 10mA maximum. (JIS C5402 5.4)	100 milliohms maximum
4-1-2 絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接するピン間及びピン、アース間にDC 500Vを印加し 測定する。 (JIS C5402 5.2 / MIL-STD-202 試験法 302) Apply 500V DC between adjacent pins or pin and ground. (JIS C5402 5.2 / MIL-STD-202 Method 302)	1000 mega ohms minimum
4-1-3 耐電圧 Dielectric Strength	隣接するピン間及びピン、アース間に AC (rms)500V (実効値) を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1 / MIL-STD-202 試験法 301) Apply 500V AC (rms) for 1 minute between adjacent pins or pin and ground. (JIS C5402 5.1 / MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown

*3 : ダミーカードとは、弊社製評価用カードを示す。

The dummy card shows the card for the evaluation made of our company.
また、本ダミーカード寸法は、“microSD Memory Card Specification”に準拠する。
The size of dummy card is based upon “microSD Memory Card Specification”.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001		FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 2/15
EN-37-1 (019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-2-1	端子、金具保持力 Terminal, nail Retention Force	毎分25±3mmの速さで端子、金具を軸方向に引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm / minute.	0.49 N MINIMUM / PIN {0.05 kgf MINIMUM / PIN}	
4-2-2	挿入力及び抜去力 Insertion / Extraction Force	毎分 25±3 mmの速さで実物カード ^{*4} を押す。 Push the actually card at the speed rate of 25±3 mm / minute.	カムロック 荷重 Lock force	10 N (1.02 kgf) maximum
			カムロック 解除荷重 Lock release force	10 N (1.02 kgf) maximum
4-2-3	カード逆差し 挿入強度 Strength against reverse insertion	実物カードを逆方向(裏・後ろ向き)に挿入し、19.6N{2.0kgf}の荷重、1秒間を1回加える。 The actual card is inserted in the opposite direction and the load of 19.6N{2.0kgf} is added for 1 second 1cycle.	外 観 Appearance	異常なきこと No damage
4-2-4	カード保持力 Card Retention Force	実物カードを嵌合させ、毎分25±3mmの速さでカードを引張る。 Pull the actually card at the speed of 25±3mm /minute.	初期値 Initial value 3.0 N MINIMUM {0.31 kgf MINIMUM}	
4-2-5	カード飛出し 制御 Card Control	コネクタ嵌合間口を上に向けた状態で、実物カードをロック後、オーバーストローク位置まで指で押し込み、瞬間的に指を離す。 In the state of turning front side to vertical direction, mate the actually card. Push card at the over-stroke position, and push out quickly.	カード飛出し 距離 Jump out range	初期 25cm以内 First time 25 cm MAXIMUM

^{*4} : 実物カードとは、最終ユーザーが使用するmicroSD Memory Cardを示す。
Actual card is microSD Memory Card, which used is end customer.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION	DOCUMENT NUMBER	FILE NAME
		PS-502570-001	PS502570001.doc
			SHEET 3/15
EN-37-1 (019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	実物カードで、1時間に400~600回の速さで挿入・抜去を10,000回繰り返す。 挿抜10回毎に、5~10分休止する。 初回~1,000回は100回毎、 1,001回~10,000回は1,000回毎に、 エアブローを3秒間行う（乾燥風）。	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum ダミーカードで測定 With the dummy card
		Insertion and extraction are repeated 10,000 cycles with the actually card at the speed rate of 400-600 cycles/hour. After each 10 cycles stop the insertion and rest the connector for 5 to 10 minutes. Air blow card (dry air) for 3secs : at each 100 cycle interval from start to 1,000 cycles. at each 1000 cycle interval from 1,001 to 10,000 cycles.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	最大許容電流(0.5A)を通电し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001		FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 4/15



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-3	耐振動性 Vibration	<p>ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に周波数10~55~10 Hz / 分、全振幅1.52mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202試験法 201)</p> <p>Mate actually card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA during the test. Amplitude: 1.52 mm P-P Frequency: 10-55-10 Hz Shall be traversed in 1 minute. (MIL STD-202 Method 201)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
			瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond maximum
4-3-4	落下衝撃 Fall down test	<p>コネクタを150gのダミー治具に取り付け、高さ180cmの位置からコンクリート面上に6面に1サイクルとして、3サイクル落下させる。</p> <p>Mount the connector in the dummy case of 150g and drop from height of 180cm on concrete side.3 times shall be applied along 3 mutually perpendicular axes.</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-5	耐衝撃性 Shock	<p>ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向(6面)に、490 m/s² (50G) の衝撃を 各3回加える。 (IEC 512-4-6c)</p> <p>Mate dummy card and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axis (6 side), passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse: Half Sine Peak value: 490 m/s² (50 G) Duration: 11 ms (IEC 512-4-6c)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
			瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond maximum

REVISE ON PC ONLY

B

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR
(PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-502570-001

FILE NAME

PS502570001.doc

SHEET

5/15

EN-37-1 (019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-6	温湿度サイクル Damp Heat Cycling	<p>ダミーカードを嵌合させ第7項に示す条件にて9サイクル行い、10サイクル目は段階6迄の試験を行う。但し、段階7aは初めの9サイクルのうち、5サイクルについて行う。試験後、室温に 24時間放置する。 (MIL-STD-202 試験法 106)</p> <p>Mate dummy card together and repeat the specified in paragraph 7 up to 10cycles. But at 10th cycle. Step 7 is omitted. And step 7a should be added</p> <p>Temperature -10°C~65°C Relative Humidity 80~98% Duration 10 cycles (1cycle 24 hours) (MIL-STD-202 Method 106)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 mega ohm minimum

REVISE ON PC ONLY

B

SEE SHEET 1 OF 15

REV.

DESCRIPTION

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR
(PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-502570-001

FILE NAME

PS502570001.doc

SHEET

6/15



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-7	温度サイクル Temperature Cycling	<p>ダミーカードを嵌合させ、-55±3°Cに30分、+85±2°Cに30分、これを1サイクルとし5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は3分以内とする。試験後、1~2時間室温に放置する。(JIS C0025)</p> <p>Mate dummy card and subjected to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.</p> <p>1cycle a) -55±3°C 30 min. b) +85±2°C 30 min. Transit time shall be within 3 min. (JIS C0025)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
4-3-8	耐熱性 Heat Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ85±2°Cの雰囲気、96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。(JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108)</p> <p>Mate dummy card and expose to 85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum

REVISE ON PC ONLY

B

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR
(PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-502570-001

FILE NAME

PS502570001.doc

SHEET

7/15



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-9	耐寒性 Cold Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ、$-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-1)</p> <p>Mate dummy card and expose to $-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
4-3-10	耐湿性 Humidity	<p>ダミーカードを嵌合させ、$40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 相対湿度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法 103)</p> <p>Mate dummy card and expose to $40\pm 2^{\circ}\text{C}$, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 mega ohm minimum

REVISE ON PC ONLY

B

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR
(PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-502570-001

FILE NAME

PS502570001.doc

SHEET

8/15



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-11	硫化水素ガス H ₂ S Gas	ダミーカードを嵌合させ、40±2℃、相対湿度80%にて、3±1ppmの水素ガス中に96時間放置する。 Mate dummy card and expose to 3±1ppm H ₂ S gas, ambient temperature 40±2℃ relative humidity 80% for 96 hours.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
4-3-12	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	ダミーカードを嵌合させ、40±2℃、相対湿度80%にて25±5ppmの亜硫酸ガス中に96時間放置する。 Mate dummy card and expose to 25±5 ppm SO ₂ gas, ambient temperature 40±2℃, relative humidity 80% for 96 hours.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum
4-3-13	塩水噴霧 Salt Spray	ダミーカードを嵌合させ、35±2℃にて5±1%重量比の塩水を48時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (MIL-STD-1344) Mate dummy card and exposed to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: 35±2 °C (MIL-STD-1344)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	変化量 change 40 milliohms maximum

REVISE ON PC ONLY

B

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR
(PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-502570-001

FILE NAME

PS502570001.doc

SHEET

9/15



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-14	半田付け性 Solderability	端子先端より0.5mmの位置まで250±5℃の半田に3±0.5秒浸す。 Dip solder tails into the molten solder (held at 250±5℃) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の90%以上 90% of immersed area must show no voids, Pinholes
4-3-15	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	第6項の条件にて、2回リフローを行う。その後、半田ごてを温度390±10℃で3±1秒間に2回、ターミナルにあてる。但し、ターミナルに異常な加圧のないこと。 Reflow by 2 times(See paragraph 6). After, touch the terminal with the soldering iron (held at 390±10℃) for 3±1 seconds by 2 times. However, without too much pressure to the terminal.	外観 Appearance	端子ガタ、割れ等異常なきこと No Damage

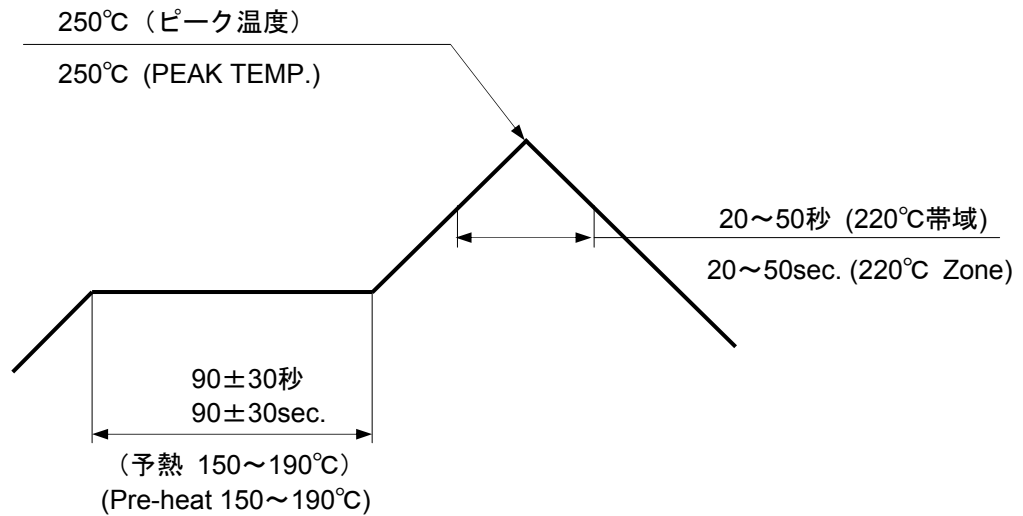
【 5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS 】

図面参照
Refer to the drawing.

REVISE ON PC ONLY	B	SEE SHEET 1 OF 15	TITLE:	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION		DOCUMENT NUMBER	FILE NAME
			PS-502570-001	PS502570001.doc
				SHEET
				10/15
EN-37-1 (019)				



【6. リフロー条件 REFLOW PROFILE】



温度条件グラフ
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(半田接合部)
(SOLDER JOINT PART)

注記
NOTES

1.本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なります。
事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。

This reflow condition may change by the actual reflow machine, p.c.boards, and so on.
Please check soldering appearance by using your own reflow condition before production
because there is a possibility of solder wicking.

2.温度条件は、半田接合部とする。
Let temperature conditions be the solder joint of connector.

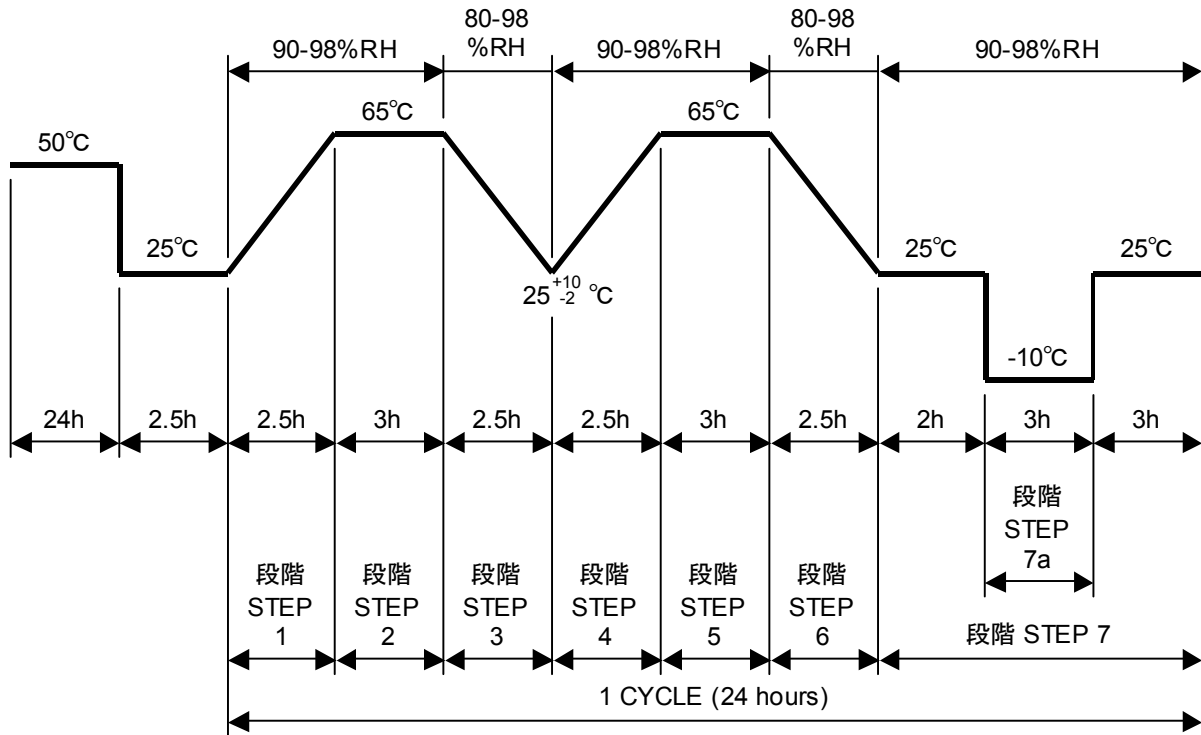
推奨メタルマスク厚さ : t=0.12mm
Thickness of METAL MASK
メタルマスク開口率 : 100%
Open aperture ratio

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001		FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 11/15



【 7. 温湿度サイクル試験条件 Damp Heat cycle condition 】

MIL-STD-202 試験法 106
MIL-STD-202 Method 106



REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001		FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 12/15
EN-37-1 (019)			



【8. 使用上の注意事項 APPLICATION NOTES】

8-1. カード抜け防止

Card omission prevention

本品にはカード抜け防止用の簡易ロックをスライダークラムに設けていますが、カードを嵌合した状態で落下させたり、衝撃を加えるとカードが抜けてきます。従って、筐体にカード抜け防止用の蓋等を設置してください。その場合、カードロック状態でのカードと蓋等の隙間は0.3mm以下にしてください。

The card is dropped while having engaged or the impact is added and the card comes off to this item though a simple lock for the card omission prevention is installed in the slider cam.

Therefore, please set up the lid for the card omission prevention etc. in the enclosure.

In that case, please adjust the spaces such as cards and lids in the state of the card lock to 0.3 mm or less.

8-2. 半田付け後の洗浄

Washing after soldering

本品を半田付け後に洗浄をする場合は、半田付け部のみ部分的に洗浄を行ってください。

ジャブ漬け等の洗浄をした場合は、カードの挿入、抜去が困難になる場合があります。

Please wash only the soldering part partially when washing after this item is soldered.

When a whole soaking etc. are washed, the insertion and extraction of the card might become difficult.

8-3. 衝撃時・負荷時におけるカード検知スイッチの電気的性能

Electrical Performance of Detect Switch to hard shock

本品に強い衝撃や強い負荷が加わると、瞬間的にカード検知スイッチとシェルが同電位になることがあります。

Electric potential of Detect Switch is equal to it of Shell for an instant, when this item is shocked and pressurized hard.

8-4. その他

Others

8-4-1. セットへの組み込み後、コネクタに直接大きな振動及び負荷等が加わらない様に、取り付け基板に固定対策をして下さい。

After mounting of connectors, connectors shall be fastened to printed circuit boards where connectors are mounted so that connectors are free from direct excessive vibration and force.

8-4-2. コネクタ接触部には触れないで下さい。

Contacts of connectors shall be kept from human touch.

8-4-3. 本仕様書記載のリフロー条件に従って実装を行って下さい。

Please mounting connectors follow to reflow condition given this specification.

8-4-4. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に、注意して下さい。

After mounting of connectors, please care of not pile up on printed circuit boards which mounted connectors directly.

8-4-5. FPC使用時の注意点 The notes at the time of FPC use

コネクタの反り防止のために実装時及び実使用時はFPCの下または周辺に補強版を入れ

コネクタを固定して下さいます様ご配慮願います。また、別途ご相談願います。

For curvature prevention of a connector, the reinforcement version is around the bottom of FPC at the time of mounting and real use, and it fixes a connector. Moreover, it consults separately – measure.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
	REV.		
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001		FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 13/15
EN-37-1 (019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

- 8-4-6. カードの無理抜き Unreasonableness omission of card
 コネクタ内でカードがロックされた状態で、カードを無理に引き抜かないようにして下さい。
 内部を破損する恐れがあります。
 Where a card is lock within a connector, please do not draw out a card by force.
 There is a possibility of damaging a core.
- 8-4-7. 適合カードは東芝社製・サンディスク社製とし、カードの厚みはコンタクト部0.8mm MAX.
 (反りを含む)とする。
 The application card is made by TOSHIBA・SanDisk. The thickness of the card is 0.8mm MAX.
 in contact area (included warpage).
- 8-4-8. カードを挿入した状態、或いはカード無理抜き等によるカムスライダーをロックした状態にて、
 リフロー等加熱はしないで下さい。加熱によるストレスによりカードロック機構が破損する
 恐れがあります。
 Please do not apply heat while the card is inside of the socket or heartcam-slider is still locked position
 by manual card extraction. The heat and stress may cause to the damage card lock mechanism.
- 8-4-9. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板
 からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部(計14ヶ所)に半田付け
 を行って下さい。
 As for the non-solder of a solder mounting part are anxious about terminal omission, short-circuit
 between pins, terminal bend, and the blank from the substrate of a connector.
 Therefore, please solder to all terminal tail parts and Neil parts (total of 14 places).
- 8-4-10. カードの裏表の逆挿しをするとカードが抜けない、またはコネクタが破損する恐れがあります。
 破損防止のためにもカードの向き・方向の表示を実機側でもお願い致します。
 If the both side of a card is put in conversely, a card will not pull out, and connector may be damaged.
 The direction and the direction of a card are displayed on a system side for breakage prevention.
- 8-4-11. カード挿入、抜去時に図面記載のカード押し込み寸法まで確実に押すように考慮した筐体デザインに
 して頂きますようお願いいたします。
 Please make sure to design your phone chassis which push the card head to maintain "card lock
 position" dimension on our drawing when inserting and extracting the card.
- 8-4-12. 繰り返し挿抜を連続的に実施した際、カード磨耗により排出がされない場合があります。
 この場合カードの清掃を行い排出が確認できれば、コネクタとしては良品と判断しております。
 Discharge may not be carried out by card friction when repetition insertion and remove is carried out
 continuously. In this case, if a card is cleaned and discharge can be checked, as a connector, it will be
 judged as the excellent article.
- 8-4-13. 本製品はカード飛び出し制御に重点を置いている為、カードの仕上がり状態により自然な排出が
 されない場合があります。この場合、カードを取り出し後、排出機構に異常が無ければ、コネクタ
 としては良品と判断しております。
 As for this product, it gives priority to the card dashing out control, and the card discharge might not be
 done by the finishing condition of card.
 In this case, if the push/push mechanism of connector is no damage after taking out the card from the
 connector, as a connector, it will be judged as the excellent article.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 15	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-502570-001		FILE NAME PS502570001.doc	SHEET 14/15
EN-37-1 (019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY:	CHECKED BY:
A	RELEASED	'08/03/10	J2008-3223	H.YAJIMA	T.HARUYAMA
B	REVISED	'11/12/14	J2012-0813	A.IDA	M.TOMITA

REVISE ON PC ONLY	
B	SEE SHEET 1 OF 15
REV.	DESCRIPTION

TITLE: microSD CARD CONNECTOR
(PUSH/PUSH & NORMAL SMALL TYPE)
製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER
PS-502570-001

FILE NAME
PS502570001.doc

SHEET
15/15